

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>券商组织的策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	天风证券 李双亮；中泰安合 贺瑞烜；中国人保 王晴； 中信资管 战佳荣；上海荣晟 周奎平；通乾投资 朱灵； 北京遵道 游懿轩；银华股份 陈子浩；华富基金 黄星霖； 上海银叶 周奎平；杭州红骅 罗世嘉；百年保险 许娟娟； LyGH Capital 华晋书；富安达 杨红；鑫元 李彪； 龙赢富泽(北京) 林永祥；天风证券股份上海证券自营分公司 王璐；碧云银霞投资管理咨询(上海) 张小瑜。
时间	2026年3月25日 14:00—15:00
地点	上海浦东嘉里城办公楼
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书介绍公司基本情况 二、互动交流 1. 请简单介绍下公司当前的业务及经营情况？ 公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业具有市场领先地位，形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块，积极成为世界先进的半导体硅材料制造商而努力奋斗。 公司当前主营业务的经营布局如下：半导体硅单晶生长及

晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地；半导体单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前处于增产上量和新客户认证过程中，客户群体增加，产品种类丰富、规格全，能够较好满足下游客户不同产品需求；江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，推动新项目、新产品投入运行。新厂房建设及机电安装工程已完成，当前正在设备安装调试过程中，随着新项目推进，未来公司将持续加大研发投入和新产品导入，进一步丰富产品结构。

2. 影响公司 2025 年度业绩的主要因素有哪些？2026 年一季度是否继续维持较好增长态势？

公司预计 2025 年度业绩变动主要原因是：（1）公司募投资项目产能释放，增产上量，产品矩阵进一步丰富；（2）公司持续精益管理，加强成本管控，通过技术创新不断提升产品盈利能力；（3）收购子公司江苏皋鑫少数股东股权，增强公司盈利能力；（4）公司基于谨慎性原则，按照相关规定计提资产减值损失。目前公司生产经营正常。

3. 贵司中晶新材料项目达产进度如何？

募投资项目以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前该项目处于增产上量和新客户认证过程中，客户群体增加，产品种类丰富、规格全，能够较好满足下游客户不同产品需求，公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进产能释放。

4. 江苏皋鑫芯片项目进展情况如何？

江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，

推动新项目、新产品投入运行。新厂房建设及机电安装工程已完成，当前正在设备安装调试过程中。随着项目推进，未来公司将迎来新的发展阶段。公司将持续加大研发投入和新产品导入，并积极推动项目建设投产，将江苏皋鑫建设成为优秀的半导体芯片研发和生产基地。

5. 公司半导体功率芯片及器件主要有哪些产品？应用于哪些领域？

江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力。江苏皋鑫生产半导体功率芯片及器件等产品，作为各类电子设备的关键零部件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV 显示器、X 光机及大型医疗设备、负离子发生器、空气净化、激光切割、高压静电喷涂、工业静电设备、油田设备、高压电源等领域。

6. 公司目前硅片产能情况如何？

公司通过自主研发与工艺革新提高产品良率和设备利用率，目前硅片产能能够较好满足下游客户不同产品需求。公司将结合实际经营情况、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进产能释放。

7. 公司未来是否有进一步扩产、产业链延伸的计划？

公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，将根据公司战略发展的需要，密切关注与半导体材料行业相关的合作契机，通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的，丰富产品结构以及下游应用领域，进一步增强技术储备和创新能力。

8. 公司产品有无进行调价？

公司产品价格主要受到市场供需关系、生产成本等因素影响，不同产品、不同细分市场和应用领域价格表现有所差异。

	<p>公司将根据生产成本、市场需求、业务合约等因素制定产品售价以及调价安排。</p> <p>9. 人工智能飞速发展，公司硅片产品应用有无涉及人工智能领域？</p> <p>公司生产的半导体硅片材料和高压整流器件产品经下游客户生产制程后，广泛应用于各类消费电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等产业。</p> <p>10. 公司目前生产上是否存在交付压力？</p> <p>公司目前具备较好的生产能力及货物交付能力, 后续公司将结合实际经营情况, 根据市场需求等情况有序规划、统筹安排, 持续为客户提供高质量的产品服务。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 3 月 25 日</p>